

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
【発行日】平成20年1月17日(2008.1.17)

【公開番号】特開2002-222831(P2002-222831A)
【公開日】平成14年8月9日(2002.8.9)
【出願番号】特願2001-20002(P2001-20002)
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/60 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/60 3 1 1 S

【手続補正書】
【提出日】平成19年11月26日(2007.11.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

この半導体チップ1表面には、一般にパッシベーション膜が形成されており、また、ボンディングパッド(あるいはランド)2と呼ばれる表面電極が形成されている。このボンディングパッド2は、アルミニウム製ボンディングパッド、金製パンプ等からなるものである。このボンディングパッド2は、例えば、半導体チップの表面にアルミニウムを蒸着した後、エッチングすることにより形成することができる。